

性能指标	典型值 RT/duroid 6002	方向	单位	条件	测试方法
介电常数 ϵ_r 过程	2.94 ± 0.04	Z	-	10GHz/23°C	IPC-TM-650, 2.5.5.5
^[2] 介电常数 ϵ_r 过程	2.94			8GHz-40GHz	差分相位长度法
损耗因子tan δ	0.0012	Z	-	10 GHz/23°C	IPC-TM-650, 2.5.5.5
ϵ_r 热稳定系数	+12	Z	ppm/°C	10 GHz 0-100°C	IPC-TM-650, 2.5.5.5
体电阻	10 ⁶	Z	Mohm cm	A	ASTM D257
表面电阻	10 ⁷	Z	Mohm	A	ASTM D257
拉伸模量	828 (120)	X,Y	MPa (kpsi)	23°C	ASTM D638
极限应力	6.9 (1.0)	X,Y	MPa (kpsi)		
极限应变	7.3	X,Y	%		
压缩模量	2482 (360)	Z	MPa (kpsi)		ASTM D638
吸水率	0.02	-	%	D48/50	IPC-TM-650, 2.6.2.1 ASTM D570
热导率	0.60	-	W/m/K	80°C	ASTM C518
热膨胀系数 (-55至288°C)	16 16 24	X Y Z	ppm/°C	23°C/50% RH	IPC-TM-650 2.4.41
Td	500		°C TGA		ASTM D3850
密度	2.1		gm/cm ³		ASTM D792
比热	0.93 (0.22)	-	J/g/K (BTU/lb/°F)	-	Calculated
铜箔剥离强度	8.9 (1.6)		lbs/in (N/mm)		IPC-TM-650 2.4.8
阻燃性	V-O				UL94
无铅工艺兼容	YES				

标准厚度	标准尺寸	标准覆铜类型
0.005" (0.127mm) 0.010" (0.254mm) 0.020" (0.508mm) 0.030" (0.762mm) 0.060" (1.524mm) 0.120" (3.048mm)	12" X 18" (305 X 457mm) 24" X 18" (610 X 457mm)	1/2oz (18um) 电解铜 (HH/HH), 反转铜 (SH/SH) 和压延铜 (5R/5R)
		1oz (35um) 电解铜 (H1/H1), 反转铜 (S1/S1) 和压延铜 (1R/1R)
		2oz (70um) 电解铜 (H2/H2), 反转铜 (S2/S2) 和压延铜 (2R/2R)
非标准厚度 0.015" (0.381mm) 0.025" (0.635mm) 0.035" (0.889mm) 0.040" (1.016mm) 0.050" (1.270mm) 0.090" (2.286mm) 0.100" (2.540mm) 0.125" (3.175mm)		可依据介质材料厚度选用厚金属覆层 也可提供非标准覆层厚度和材料尺寸 更多信息请联系 客服

如您需要微波高频线路板的技术支持或报价服务, 请联系 iPcb.cn, 邮箱: sales@iPcb.cn 或者进入网站自动报价: www.iPcb.cn